

概 要

本概要旨在向閣下提供本文件所載資料的概覽。由於僅為概要，因此不包含可能對閣下重要之全部資料。閣下在決定[編纂][編纂]前，應細閱整份文件。特別是，由於我們無法滿足上市規則第8.05(1)、(2)或(3)條的規定，我們是根據上市規則第十八C章尋求在香港聯交所主板[編纂]的特專科技公司。[編纂]於我們這類公司涉及獨特的挑戰、風險及不確定性。此外，我們自成立以來已產生淨虧損，且在可見未來我們亦可能會產生淨虧損。於往績記錄期間，我們錄得經營活動所用現金淨額。於往績記錄期間，我們並無宣派或派付任何股息，且可能不會於可見未來派付任何股息。閣下應根據該等考量因素作出[編纂]決定。

任何[編纂]均涉及風險。[編纂]於[編纂]的部分特定風險載於本文件「風險因素」一節。閣下在決定[編纂][編纂]前，應細閱該節全文。

概覽

我們是泛半導體行業領先的智能製造軟件解決方案提供商，專注於為泛半導體行業所應用先進製造而量身定制的智能製造軟件解決方案的研發與商業化。自成立以來，我們戰略聚焦半導體行業，運用人工智能、大數據及自動化等新技術，通過自主研發，提供場景驅動的全棧智能製造軟件解決方案。我們的智能製造解決方案在設計和開發方面與泛半導體行業的先進製造工藝和技術深度融合，建立了行業競爭力並在業界保持長期領先優勢。根據弗若斯特沙利文的資料，按智能製造軟件解決方案產生的收入計，於2024年，我們在中國泛半導體智能製造軟件市場的國內泛半導體智能製造軟件解決方案提供商中排名首位。

自我們於2007年成立以來，我們的創始人孫先生捕捉半導體行業的發展機遇，致力於成為領先並擁有自主研發的計算機集成製造系統的智能製造軟件解決方案提供商。於2010年，我們首次上線了8寸半導體製造執行系統。此外，2023年初，我們成功交付了12寸前道18納米工藝含核心製造執行系統的國產計算機集成製造系統，成為國內首批實現12寸晶圓製造全廠全自動化智能製造軟件解決方案突破的供應商之一。憑藉可擴展的生產能力，我們已成功進軍顯示面板、印刷電路板及光伏領域，具備進一步拓展泛半導體產業佈局的優勢。我們構建了融合尖端技術的智能製造軟件解決方案產品組合，致力於通過發揮現有解決方案的特性並運用新技術，持續提升客戶的生產效率。

概 要

近年來，我們藉助人工智能的發展，不斷優化和提升智能製造軟件解決方案。憑藉在泛半導體行業的深入研究和深厚專業知識，我們推出了面向泛半導體行業各類先進製造場景的人工智能賦能智能製造軟件解決方案。我們的人工智能模型持續從生產及運營數據中學習，實現自感知、自學習、輔助決策，幫助產線提升產能和品質，降低損耗成本。通過融合先進的計算機視覺和強化學習技術，我們提供閉環控制解決方案，全面提升工廠效率。

我們為整個泛半導體行業的多元化客戶群提供服務。於往績記錄期間，我們與泛半導體行業的超過290家客戶建立了業務關係，其中半導體行業的客戶約為160家。此外，我們已與領先的先進製造企業（包括中芯國際集成電路製造（北京）有限公司、客戶集團A及天馬微電子股份有限公司）建立長期合作夥伴關係，形成了強大的競爭力。截至2022年、2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年4月30日止四個月，我們來自五大客戶的收入分別為人民幣69.2百萬元、人民幣89.7百萬元、人民幣116.2百萬元及人民幣42.5百萬元，分別佔我們收入的62.4%、54.2%、46.7%及52.5%。

於往績記錄期間，我們自智能製造軟件解決方案及較少量的維護服務產生收入。我們的收入由2022年的人民幣111.0百萬元增加至2023年的人民幣165.5百萬元，並進一步增加至2024年的人民幣248.9百萬元。我們的收入由截至2024年4月30日止四個月的人民幣77.8百萬元增加至截至2025年4月30日止四個月的人民幣81.1百萬元。於往績記錄期間，我們錄得強勁的收入增長，彰顯我們成功商業化解決方案及服務的能力。

下表載列往績記錄期間按貨品或服務類型（即智能製造軟件解決方案（「IMSS」）及維護服務）劃分的收入明細，以所示期間的絕對金額及佔總收入百分比列示：

	截至12月31日止年度						截至4月30日止四個月			
	2022年		2023年		2024年		2024年		2025年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
	(未經審計)									
IMSS.....	109,937	99.1	163,777	99.0	246,598	99.1	76,944	99.0	80,288	99.1
維護服務.....	1,044	0.9	1,717	1.0	2,293	0.9	814	1.0	762	0.9
總計	110,981	100.0	165,494	100.0	248,891	100.0	77,758	100.0	81,050	100.0

概 要

業務模式及解決方案

我們為一家上市規則第十八C章所界定的商業化公司。我們自主開發了基於交易的業務模式，其五大平台包含一系列系統模塊，即：(i)生產運營平台；(ii)集成自動化平台；(iii)智控數字平台；(iv)智能大數據引擎平台；及(v)數字化設備平台。我們的生產運營平台及集成自動化平台下的系統模塊形成了我們的主打產品（即CIM軟件解決方案），該產品分別在2022年、2023年和2024年以及截至2024年及2025年4月30日止四個月貢獻了我們總收入的68.0%、82.7%、78.5%、92.9%及78.7%。

生產運營平台

我們的生產運營平台圍繞自研的製造執行系統MESwell[®]，集成數字化統一的質量管理系統模塊、高級計劃排產(APS)及實時排產(RTD)，構建高效、精準及可視化的生產管理平台。

- **製造執行系統(MESwell)[®]**：MESwell[®]是為泛半導體行業的先進製造量身打造的製造執行系統，具備生產排程、物料管理、設備管理、質量管理等功能。
- **質量管理系統(QMS)**：QMS是一個綜合數字平台，用於標準化及自動化整個泛半導體行業的質量控制流程。
- **高級計劃排產(APS)**：APS是一種基於軟件的方法，它使用實時數據和優化算法來同步製造和供應鏈活動，平衡客戶對有限資源（如機器、勞動力和材料）的需求制定精確的生產計劃和時間表，從而縮短交貨時間、減少庫存和浪費，並最大限度地提高資產利用率。
- **實時排產(RTD)**：客戶可以在RTD系統中預先輸入生產計劃／規則和調度規則。當有生產調度需求時，RTD系統能夠結合生產計劃／規則、調度規則、生產數據以及設備實時狀態，即時計算出最優批次，並自動生成調度命令（運輸指令）並下發至物流控制系統(MCS)，實現生產調度和運輸的全自動化。

概 要

集成自動化平台

作為全廠建設自動化必不可少的系統，集成自動化平台實現工廠數據的整合、採集及傳輸，用於工廠內部的物流自動化控制。我們集成自動化平台下的核心系統模塊包括：(i)設備自動化系統(EAP)、(ii)區塊控制系統(BC)及(iii)物料控制系統(MCS)。

- *設備自動化系統(EAPwell®)*：EAPwell®是一套通過設備直連強化生產流程管理的綜合系統。
- *區塊控制系統(BC)*：BC是以工業物聯網技術為依托的智能製造合作平台。
- *配方管理系統(RMS)*：RMS為一個全面管理平台，旨在於半導體及先進製造環境中實現設備配方控制的標準化與自動化。
- *物料控制系統(MCS)*：MCS是智能物流控制平台，通過統一協議將跨品牌、跨類型的異構物料搬運設備進行集成。

智控數字平台

我們的智控數字平台作為工廠管理的統一入口平台，提高中控人員的執行效率，協助管理者決策。我們依托自研技術、專業知識及行業了解推出LOFA產品及正在研發GloryIGI中，旨在實現現實製造需求和工業技術開發之間的協同效應，更好地滿足泛半導體行業各個領域客戶及合作夥伴的多樣化需求。我們智控數字平台下的核心系統模組類別包括：(i) LOFA-PCC/RCM、(ii) LOFA-Bots/RPA、(iii) LOFA-AI/ADC及(iv) GloryIGI。

- *LOFA-PCC/RCM*：遠程控制管理(RCM)系統是軟硬件集成解決方案，旨在滿足先進製造業的各項需求，包括降低人工成本、提高生產效率及提升產品質量。
- *LOFA-Bots/RPA*：機器人流程自動化(RPA)是專為提供端到端業務自動化而設計的解決方案，依托智能化技術，替代人工進行重複性、低價值及規則明確的工作流程。

概 要

- *LOFA-AI/ADC*：自動缺陷分類(ADC)系統是一套AI驅動的視覺檢測系統模組，旨在實現製造過程中缺陷檢測和分類的自動化。
- *GloryIGI*：GloryIGI是我們為泛半導體行業量身定制的全方位生態系統解決方案，源自對特定行業需求的深入洞察與領域專業知識的協同融合。

智能大數據引擎平台

我們的智能大數據引擎平台以智能算法與工程方法相結合為核心，彌補了人員經驗不足的影響，應用場景眾多，包括設備異常排查、質量異常原因排查、參數優化分析等。我們智能大數據引擎平台下的核心系統模組類別包括(i)良率管理系統(YMS),(ii)智能錯誤偵測分類(FDC)及(iii)虛擬量測和設備健康管理(VM&EHM)。

- *良率管理系統(YMS)*：YMS是一個先進分析系統模組，用於優化半導體、PCB及其他泛半導體行業的生產良率及質量控制。
- *智能錯誤偵測分類(FDC)系統*：FDC是一個智能設備管理系統模組，用於通過數據收集、統計分析及AI驅動建模實時監控關鍵設備參數的穩定性並將故障分類。
- *虛擬量測和設備健康管理(VM&EHM)*：VM系統為AI驅動的軟件解決方案，旨在通過將設備及工藝參數與統計及機器學習模型相結合，預測產品特性(如薄膜厚度、阻抗、線寬)。

數字化設備平台

我們的數字化設備平台採用組件化、腳本化及模塊化架構，賦能先進設備製造商開發高性能自動控制系統，涵蓋設備軟件套件及仿真解決方案。我們數字化設備平台的核心解決方案包括：(i)集群工具架構(CTF)、(ii)設備通訊轉換模塊(iEQ)及(iii)工藝設計與仿真(PDS)。

- *集群工具架構(CTF)*：CTF是本集團專有的國產半導體設備軟件平台，為設備製造商提供高效、靈活且可擴展的軟件解決方案。

概 要

- **設備通訊轉換模塊(iEQ)**：iEQ是本集團自主研發的專有核心工業通訊解決方案，專門為泛半導體行業企業提供高效穩定的設備通訊及數據交換服務。
- **工藝設計與仿真(PDS)**：PDS是一款用於優化半導體製造工藝的先進仿真和校正工具。

主要營運數據

下表載列我們的主要收入來源智能製造軟件解決方案(IMSS)在客戶開發及留存方面的關鍵指標，這是我們早期商業化階段的重中之重（投資者應同時根據淨收入留存率及所有營運數據衡量我們的整體表現，二者應被視為同等重要）：

	截至12月31日止年度			截至4月30日
				止四個月
	2022年	2023年	2024年	2025年
IMSS總收入(人民幣千元).....	109,937	163,777	246,598	80,288
客戶數量.....	101	134	147	62
新客戶數量 ⁽¹⁾	不適用	83	90	37
平均客戶價值 ⁽²⁾ (人民幣千元).....	1,088	1,222	1,678	1,295
與客戶的交易次數.....	171	225	271	77
平均客戶交易價值 ⁽³⁾ (人民幣千元).....	643	728	910	1,043
客戶留存率 ⁽⁴⁾	不適用	50.5%	42.5%	17.0%

附註：

- (1) 指上一年度未向我們購買產品或解決方案的客戶。
- (2) 按特定年度／期間產生的收入除以該年度／期間客戶數量計算。
- (3) 按特定年度／期間產生的收入除以該年度／期間交易次數計算。
- (4) 按相關年度／期間客戶數量與相關年度／期間新增客戶數量之差除以上一年度客戶數量，再乘以100%計算。

概 要

我們的優勢

我們認為，以下競爭優勢助力我們取得成功，並讓我們從競爭對手中脫穎而出：

- (1) 國內頂尖的穩健泛半導體行業全棧自研智能製造軟件解決方案提供商；
- (2) 通過強大的內部研發，引領技術創新和突破；
- (3) 戰略性客戶合作夥伴關係和強大的客戶壁壘；
- (4) 以AI為導向的LOFA產品群，提升生產效率；及
- (5) 堅韌、創新、富有遠見的管理團隊。

我們的策略

我們擬推行以下策略以進一步發展我們的業務：

- (1) 加強以客戶為導向的市場影響力及圍繞核心產品尋求合作機會；
- (2) 推進AI產品迭代，建構完善應用場景矩陣；
- (3) 構建以人工智能為導向的智能製造生態系統；
- (4) 加速全球佈局，賦能中國企業，推動中國智能製造技術走向世界；及
- (5) 吸引頂尖及潛在行業人才，深化泛半導體領域研發。

研發

我們開發新技術、設計新解決方案以及增強現有解決方案的能力對維持我們的市場地位至關重要。

我們的研發團隊由具有專業知識和豐富行業經驗的敬業人才組成，專注於開發及商業化我們的解決方案，這有助於保持我們的技術優勢和市場競爭力。截至2025年4月30日，我們的研發團隊由116名成員組成，佔員工總數的22.3%。彼等在數學、電腦科學、物理學與半導體技術領域擁有多學科專業知識，共同為研發提供了見解與經驗。我們的研發團隊成員擁有出色的背景，其中多數擁有高級學位，並從頂尖院校及知名業界參與者習得寶貴經驗。截至2025年4月30日，我們的研發團隊成員中有12.1%擁有碩士或更高學位。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2024年及2025年4月30日止四個月，我們的研發成本分別為人民幣55.5百萬元、人民幣66.4百萬元、人民幣59.0百萬元、人民幣20.3百萬元及人民幣16.1百萬元，分別佔我們同期經營開支總額的48.4%、48.5%、43.6%、46.8%及35.0%。

概 要

於往績記錄期間，我們並無將任何重大知識產權轉入許可或外判任何研發流程予第三方。此外，我們一般不會與第三方合作進行任何研發項目。自成立以來，我們並未遭遇任何可能影響我們智能製造軟件解決方案研發的法律申索或訴訟。

知識產權

以下各項對我們未來的商業成功至關重要：我們能夠獲得並維護與業務相關且具有重要商業價值的技術、發明及專有技術的專利及其他產權保護；捍衛並行使我們的知識產權，尤其是我們的專利、商標及版權；維護我們商業機密的保密性；以及在不侵權、盜用或侵犯有效且可執行的第三方專利及產權的情況下運營。我們保護知識產權的方式為：(1)在我們簽訂的全職僱傭協議中訂明與知識產權的所有權及保護相關的全部權利及義務、(2)積極追蹤知識產權的註冊及授權狀態，並在得悉任何可能侵犯我們知識產權的行為時及時採取行動。

我們擁有對我們的智能製造軟件解決方案而言屬重大的自有知識產權。截至最後實際可行日期，我們在中國境內取得25項專利、14項商標及145項軟件著作權。我們在中國境內獲授的專利包括24項發明專利及1項設計專利。此外，截至最後實際可行日期，我們亦已申請超過10項海外專利。我們的專利及版權構成了技術基礎架構的核心，令我們得以開發創新產品及服務，從而提升競爭優勢。我們的商標對聲譽、品牌知名度及市場推廣活動而言至關重要。請參閱「附錄六一法定及一般資料」。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們概無涉及任何針對我們或由我們提告的有關知識產權侵權索賠的重大訴訟。董事確認，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，彼等並無發現有關我們侵犯任何第三方知識產權的任何法律、仲裁或行政程序。根據聯席保薦人的盡職調查，聯席保薦人並不知悉任何與上述相反的情況。

客戶及供應商

於往績記錄期間，我們的客戶主要包括泛半導體行業的中國製造商。於截至2022年、2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年4月30日止四個月，來自五大客戶的收入分別為人民幣69.2百萬元、人民幣89.7百萬元、人民幣116.2百萬元及人民幣42.5百萬元，分別佔我們收入的62.4%、54.2%、46.7%及52.5%。截至2022年、2023

概 要

年、2024年12月31日止年度及截至2025年4月30日止四個月，來自最大客戶的收入分別為人民幣34.7百萬元、人民幣33.1百萬元、人民幣49.2百萬元及人民幣11.7百萬元，分別佔我們收入的31.3%、20.0%、19.8%及14.5%。

於往績記錄期間，我們的供應商主要包括硬件提供商、軟件提供商及技術服務提供商。截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年4月30日止四個月，向五大供應商的採購額分別為人民幣43.0百萬元、人民幣21.5百萬元、人民幣20.1百萬元及人民幣10.2百萬元，分別佔我們同期採購總額的57.0%、15.4%、9.9%及15.9%。截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年4月30日止四個月，向最大供應商的採購額分別為人民幣10.8百萬元、人民幣9.3百萬元、人民幣6.9百萬元及人民幣4.1百萬元，分別佔我們同期採購總額的14.2%、6.6%、3.4%及6.3%。

市場機會及競爭

泛半導體行業作為技術進步的主要驅動力增長迅速，為我們創造重大發展機遇。從行業前景看，當中的半導體、顯示面板、PCB和光伏等行業擁有廣闊的市場機會。具體而言，中國的半導體市場由2020年的人民幣10,454億元增加至2024年的人民幣15,207億元，複合年增長率為9.8%，並預計在2029年達到人民幣26,853億元，複合年增長率為12.0%。中國顯示面板行業的市場規模經歷了顯著增長，由2020年的人民幣0.4萬億元增加至2024年的人民幣1.3萬億元，複合年增長率為30.7%，2029年將達到人民幣6.5萬億元，複合年增長率為37.9%。中國的PCB行業產值由人民幣351億元達到2024年的人民幣450億元，複合年增長率為6.4%。預計2029年將達到人民幣615億元，複合年增長率為6.5%。在光伏行業，中國的累計光伏裝機容量已由2020年的257.7 GW大幅增至2024年的1080.0GW，複合年增長率為43.1%，並將於2029年達到8,174.3 GW，複合年增長率為49.9%。

近期，數據驅動的人工智能大模型將在泛半導體行業所應用先進製造的智能製造軟件解決方案中得到更廣泛和深入的應用。國內製造商在產品穩定性和技術綜合性方面不斷取得突破，抓住自研及穩定性的必然趨勢。為應對市場需求，行業正在從傳統生產向應用人工智能生產的整體解決方案過渡，中國製造商加快走出去的步伐，不斷開拓新興市場。中國泛半導體智能製造軟件解決方案市場規模由2020年的人民幣11億元增至2024年的人民幣21億元，複合年增長率為19.2%。預計到2029年，市場規模將增至人民幣66億元，反映了預測期間強勁的複合年增長率，為25.4%。我們將把握此發展趨勢，快速響應客戶需求，深耕各類應用場景，從而把握泛半導體行業變革帶來的顯著增長潛力。

概 要

根據弗若斯特沙利文報告，於2024年，我們在中國泛半導體智能製造軟件解決方案市場的國內泛半導體智能製造軟件解決方案提供商中排名首位，為首家實現泛半導體行業價值鏈各個環節的軟件解決方案全覆蓋的中國公司，提供從材料、加工到元器件、組裝、下游應用的端到端解決方案，覆蓋泛半導體所有行業。

有關我們競爭優勢、所處行業及所面臨的風險詳情，請參閱本文件其他部分所載的「行業概覽」及「風險因素－與我們一般營運及行業有關的風險」各節。

風險因素

我們專為泛半導體產業量身打造的智能製造軟件解決方案的商業化處於相對早期階段，因為於往績記錄期間，我們僅在2024年收入增長後，方符合上市規則第18C.03(4)條所載的收入規定。此外，於往績記錄期間，我們錄得虧損淨額，並預期於往績記錄期間後仍將繼續錄得虧損。我們相信我們的營運涉及若干風險及不確定因素，當中部分風險及不確定因素非我們所能控制。

我們的業務及[編纂]涉及若干風險，該等風險載於本文件「風險因素」一節。我們面臨的部分主要風險因素包括：(1)倘若因宏觀經濟影響及其自身業務狀況，我們的客戶對[編纂]新技術變得更加謹慎，我們的業務、經營業績及財務狀況將受到不利影響；(2)探索新業務模式及開發新解決方案及服務以及實施增長策略涉及風險及挑戰；(3)由於多種因素，我們的泛半導體智能製造軟件解決方案市場規模及對我們解決方案及服務的需求可能不會如我們預期般迅速增加，從而對我們的業務、經營業績、財務狀況及前景造成重大不利影響；(4)我們在競爭非常激烈的市場中經營，既有老牌競爭者，亦有新市場進入者；及(5)我們大部分的收益來自泛半導體行業的客戶，使我們受到監管環境、市場規模及其他影響泛半導體行業的因素的影響。

概 要

歷史財務資料概要

下表載列往績記錄期間綜合財務資料的財務數據概要，乃摘錄自附錄一所載的會計師報告。下文所載綜合財務數據概要應與本文件綜合財務報表（包括相關附註）一併閱讀。我們的綜合財務資料乃根據國際財務報告準則編製。

	截至12月31日止年度			截至4月30日止四個月	
	2022年	2023年	2024年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審計)				
收入	110,981	165,494	248,891	77,758	81,050
銷售成本	(92,180)	(159,790)	(216,141)	(59,147)	(76,117)
貨品及服務銷售成本	(73,095)	(132,475)	(191,698)	(54,120)	(69,202)
虧損合約 (撥備)					
/ 撥回淨額	(608)	(3,057)	(9,196)	1,187	29
存貨減值虧損淨額	(18,477)	(24,258)	(15,247)	(6,214)	(6,944)
毛利	18,801	5,704	32,750	18,611	4,933
其他收入及收益淨額	11,685	12,362	11,717	1,684	6,037
銷售及營銷開支	(27,717)	(37,600)	(45,853)	(13,484)	(11,307)
行政開支	(31,318)	(32,815)	(30,609)	(9,622)	(18,568)
研發開支	(55,466)	(66,420)	(59,020)	(20,321)	(16,080)
金融及合約資產減值虧損淨額 ..	(1,811)	(6,154)	(10,160)	(6,842)	(7,710)
其他開支	(1)	(35)	(117)	(21)	(6)
財務成本	(1,053)	(2,233)	(1,831)	(592)	(642)
除稅前虧損	(86,880)	(127,191)	(103,123)	(30,587)	(43,343)
所得稅	-	-	-	-	-
年 / 期內虧損	(86,880)	(127,191)	(103,123)	(30,587)	(43,343)

概 要

非國際財務報告準則計量

為補充我們按照國際財務報告準則呈列的綜合財務報表，我們亦使用並非國際財務報告準則規定或按其呈列的經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）作為附加財務計量指標。我們認為該等非國際財務報告準則計量有助於消除管理層認為對我們營運表現並無指示性意義的項目的潛在影響，從而可以就不同期間及不同公司的營運表現進行對比。我們認為，該等計量指標為投資者及其他人士提供有用資訊，使其以與我們管理層所採用者相同的方式了解並評估我們的綜合經營業績。然而，我們所呈列的經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）未必可與其他公司所呈列類似名義的計量指標相比。非國際財務報告準則計量指標用作分析工具存在局限性，閣下不應將其視為獨立於或可替代我們根據國際財務報告準則所呈報經營業績或財務狀況的分析。

我們將經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）定義為經股份支付開支及[編纂]開支調整的年／期內淨虧損。股份支付開支主要指與授予管理層及主要僱員的獎勵有關的非現金僱員福利開支。[編纂]開支與[編纂]有關。

下表載列我們截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2024年及2025年4月30日止四個月的經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）與根據國際財務報告準則編製的最接近計量（即年／期內淨虧損）的對賬。

	截至12月31日止年度			截至4月30日止四個月	
	2022年	2023年	2024年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
年／期內虧損	(86,880)	(127,191)	(103,123)	(30,587)	(43,343)
加：					
股份支付開支	1,304	1,480	1,594	418	949
[編纂]開支	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
經調整淨虧損（非國際 財務報告準則計量） ..	<u>(85,576)</u>	<u>(125,711)</u>	<u>(101,529)</u>	<u>(30,169)</u>	<u>(32,430)</u>

概 要

綜合財務狀況表概要

下表載列截至所示日期我們的綜合財務狀況表概要。

	12月31日			4月30日
	2022年	2023年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元 (未經審計)
非流動資產總值.....	16,902	27,264	15,858	15,771
流動資產總值.....	434,187	584,247	448,903	377,245
流動負債總額.....	239,664	291,058	249,626	220,605
流動資產淨值.....	194,523	293,189	199,277	156,640
資產總值減流動負債.....	211,425	320,453	215,135	172,411
非流動負債總額.....	5,856	4,670	3,881	3,587
資產淨值.....	205,569	315,783	211,254	168,824
權益總額.....	205,569	315,783	211,254	168,824

於往績記錄期間，截至2022年、2023年及2024年12月31日以及2025年4月30日，我們分別錄得淨資產人民幣205.6百萬元、人民幣315.8百萬元、人民幣211.3百萬元及人民幣168.8百萬元，主要是由於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資、存貨及其他合約成本、貿易應收款項及應收票據以及合約資產波動所致。有關往績記錄期間綜合財務狀況表關鍵項目的波動詳情，請參閱「財務資料－綜合財務狀況表若干關鍵項目的討論」。

綜合現金流量表概要

	截至12月31日止年度			截至4月30日止四個月	
	2022年	2023年	2024年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元 (未經審計)
經營所用現金.....	(100,434)	(116,671)	(143,680)	(59,044)	(66,336)
已收利息.....	408	380	394	67	46
經營活動所用現金淨額.....	(100,026)	(116,291)	(143,286)	(58,977)	(66,290)
投資活動所得／(所用)					
現金淨額.....	60,731	(167,487)	142,759	71,086	68,997

概 要

	截至12月31日止年度			截至4月30日止四個月	
	2022年	2023年	2024年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
融資活動所得／(所用)					
現金淨額.....	5,557	280,089	(4,183)	(30,139)	(4,071)
現金及現金等價物減少淨額.....	(33,738)	(3,689)	(4,710)	(18,030)	(1,364)
年／期初現金及現金等價物.....	76,793	43,083	39,397	39,397	34,689
匯率變動的影響，淨額.....	28	3	2	-	3
年／期末現金及現金等價物.....	<u>43,083</u>	<u>39,397</u>	<u>34,689</u>	<u>21,367</u>	<u>33,328</u>

我們於2022年、2023年及2024年以及截至2024年及2025年4月30日止四個月的經營活動所用現金淨額分別為人民幣100.0百萬元、人民幣116.3百萬元、人民幣143.3百萬元、人民幣59.0百萬元及人民幣66.3百萬元。於往績記錄期間，我們持續錄得經營活動所得現金流出淨額，主要由於(i)往績記錄期間產生淨虧損；(ii)非現金項目調整，主要是存貨減值虧損；(iii)我們營運資金的變動，主要是存貨及合約成本、貿易應收款項及票據以及合約資產、其他應付款項、已收按金及應計費用以及合約負債的波動。

我們已採取並將繼續採取各種措施改善我們的現金流量狀況，包括(i)定期評估主要經營開支的必要性及緊迫性，規劃及監察我們的流動資金狀況；(ii)積極跟進客戶付款事宜，密切監察貿易應收款項的回收情況；(iii)密切關注未結算貿易應收款項結餘的累積，並及時與客戶跟進結算；(iv)利用與供應商的合作關係，與供應商磋商更長的信貸期；及(v)與主要往來銀行維持穩定關係，以在必要時安排使用銀行融資。

董事認為，考慮到我們下述可動用的財務資源，我們的營運資金足以應付我們自本文件日期起至少未來12個月的需求：(i)我們的未來經營現金流量；(ii)現金及現金等價物；(iii)可用銀行融資；(iv)估計[編纂][編纂]淨額。

概 要

資金消耗率

我們的現金消耗率指(i)經營活動所用現金淨額，(ii)購買物業及設備及無形資產的付款，及(iii)租賃付款的平均每月總額。我們於2022年、2023年及2024年以及截至2025年4月30日止四個月的歷史每月平均現金消耗率分別為人民幣8.9百萬元、人民幣10.2百萬元、人民幣12.3百萬元及人民幣17.1百萬元。截至2025年7月31日，我們的現金及現金等價物、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資及未動用銀行融資合共為人民幣411.9百萬元。我們估計，經扣除[編纂]所用[編纂]開支後，我們將收到[編纂]淨額約[編纂]港元（假設[編纂]未獲行使，並假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即本文件指示性[編纂]的中位數）。

假設未來的平均現金消耗率與2024年的現金消耗率水平相似，為人民幣[12.3]百萬元（此金額可能因各項因素而變動，包括但不限於業務發展、行業趨勢及客戶需求），我們估計，我們截至2025年7月31日的現金及現金等價物、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資及未動用銀行融資將能夠維持我們約[33.5]個月的財務可行性，倘我們計及估計[編纂][編纂]淨額的[編纂]%（即分配作營運資金及其他一般公司用途的部分），則能夠維持[編纂]個月，倘我們亦計及估計[編纂][編纂]淨額，則能夠維持[編纂]個月。我們將繼續密切監控我們的經營現金流量，並透過各種方式（其中包括銀行融資及外部融資）維持我們的財務可行性。請參閱「一 債務」。

關鍵財務比率

下表載列我們截至所示日期／年／期內的若干關鍵財務比率：

	截至12月31日／截至該日止年度			截至4月30日／ 截至該日 止四個月
	2022年	2023年	2024年	2025年
淨虧損率 ⁽¹⁾	(78.3)%	(76.9)%	(41.4)%	(53.5)%
流動比率 ⁽²⁾	1.8	2.0	1.8	1.7
速動比率 ⁽³⁾	1.1	1.5	1.4	1.3
資產負債比率 ⁽⁴⁾	0.1	0.2	0.3	0.4

概 要

附註：

- (1) 按虧損淨額除以相關年度／期間的收入再乘以100%計算。
- (2) 流動比率按截至年／期末的流動資產除以流動負債計算。
- (3) 速動比率乃按截至年／期末的流動資產減存貨及其他合約成本除以流動負債計算。
- (4) 資產負債比率按年／期末銀行借款及租賃負債總額除以相應年／期末權益總額計算。

我們的控股股東

截至最後實際可行日期，本公司執行董事、董事長兼總經理孫先生合共控制本公司約53.87%投票權，包括(1)其直接實益擁有的約30.18%；(2)孫先生作為唯一普通合夥人控制的昕想有限合夥實益擁有的約14.34%；及(3)孫先生作為唯一普通合夥人控制的晶為有限合夥實益擁有的約9.34%。昕想有限合夥為本公司的股權激勵平台，晶為有限合夥為孫先生、執行董事姜志先生及我們若干財務投資者的持股平台。有關進一步詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」及「與控股股東的關係」。

[編纂]前投資

自本公司註冊成立以來，為提供資金以實現戰略增長並擴大股東基礎，我們已進行數輪[編纂]前投資。有關我們[編纂]前投資的主要條款以及我們[編纂]前投資者的身份及背景的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」。

[編纂]於聯交所[編纂]

我們已向[編纂]申請[編纂]根據[編纂]已[編纂]及將予[編纂]的H股（包括因行使[編纂]而可能[編纂]的任何H股）[編纂]及[編纂]以及將未上市股份[編纂]為H股，前提是（其中包括）參考我們[編纂]時的預期市值，我們作為一家商業公司（定義見上市規則）符合上市規則第18C.03條的要求，該要求已由聯交所及證監會根據2024年8月23日發佈的證監會及聯交所《就特專科技公司及特殊目的收購公司併購交易規定作短期修改刊發聯合公告》進行修改。基於[編纂]，本公司預計[編纂]時的市值將超過40億港元。

概 要

[編纂]開支

[編纂]開支指與[編纂]相關的專業費用、[編纂]佣金及其他費用。我們估計包括[編纂][編纂]佣金在內的[編纂]開支約為[編纂]港元（包括(i)[編纂]佣金約[編纂]港元；及(ii)非[編纂]相關開支，其中包括法律顧問及申報會計師費用及開支約[編纂]港元，以及其他費用及開支約[編纂]港元），佔[編纂][編纂]總額約[編纂]%（假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的中位數）且未行使[編纂]調整權及[編纂]）。在[編纂]開支總額中，約[編纂]港元將從權益中扣除；約[編纂]港元已於往績記錄期間支出，餘下約[編纂]港元預計將於[編纂]時支出。

[編纂]統計數據

下表中的所有統計數據均基於(1)[編纂]已完成及根據[編纂][編纂][編纂]股[編纂]；(2)[編纂]未獲行使。

	基於[編纂]每股 H股[編纂]港元	基於[編纂]每股 H股[編纂]港元
股份市值 ⁽¹⁾	[編纂]港元	[編纂]港元
未經審計[編纂]經調每股有形資產淨值 ⁽²⁾	[編纂]港元	[編纂]港元

(1) 股份市值乃基於緊隨[編纂]完成後預期將[編纂]的[編纂]股股份計算得出（假設[編纂]未獲行使）。

(2) 未經審計[編纂]經調整合併每股有形資產淨值乃基於（假設[編纂]已於[編纂]完成）合共已[編纂][編纂]股股份（相當於[編纂]已[編纂][編纂]股股份及[編纂]將予[編纂][編纂]股H股）計算。

概 要

未來計劃及[編纂]用途

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍的中位數），且經扣除[編纂]費用及佣金及與[編纂]有關的其他估計開支，並假設[編纂]未獲行使，我們估計我們將收取的[編纂][編纂]淨額約為[編纂]港元。我們擬將[編纂][編纂]淨額用於以下目的：(1)約[編纂]%或[編纂]港元用於持續提升我們的研發能力和解決方案供應；(2)約[編纂]%或[編纂]港元將用於選擇性地尋求國內外戰略聯盟、投資、併購機會；(3)約[編纂]%或[編纂]港元將用於通過以下方式提升我們的商業化能力：擴展國內外銷售與服務網絡，以及提升客戶服務質量以維持並深化現有客戶關係；及(4)約[編纂]%或[編纂]港元將用作營運資金及一般企業用途。

有關我們的未來計劃及[編纂][編纂]用途（包括在[編纂]定為高於或低於估計[編纂]範圍的中位數時對[編纂]分配的調整）的進一步資料，請參閱「未來計劃及[編纂]用途」。

股息及股息政策

於往績記錄期間，本公司或本集團旗下的其他實體概無派付或宣派任何股息。任何宣派及派付股息以及股息金額均須遵守我們的公司章程及相關中國法律。我們目前並無任何股息政策或固定股息派息率。股息僅可從合法可供分派的溢利及儲備中宣派或派付。經我們的中國法律顧問確認，根據相關中國法律，我們獲得的任何未來淨利潤將須首先用於彌補我們的過往累計虧損，其後我們將須分配10%的淨利潤至我們的法定公積金，直至該公積金達到我們註冊資本的50%以上。因此，我們將僅能夠在(i)我們所有過往累計虧損已彌補；及(ii)我們已按上文所述分配足夠純利至法定公積金後宣派股息。

概 要

近期發展及無重大不利變動

近期發展

於往績記錄期間後及直至最後實際可行日期，我們的業務模式維持不變，且我們繼續提升及開發我們的產品並擴大我們的客戶基礎。特別是，我們在以下領域取得了重大突破：

- **客戶對LOFA服務的認可**：於2025年5月及2025年6月，我們在泛半導體領域成績斐然，成功取得三項協議，整合我們的LOFA產品（如LOFA-PCC/RCM、LOFA-Bots/RPA及LOFA-AI/ADC）。該等項目涵蓋探針標記檢測及自動審查等各個方面，從而提高半導體行業所採用先進製造的準確性及可擴展性。該等項目標誌著領先的半導體製造商持續採用我們的LOFA產品，彰顯了我們的技術競爭力。
- **AI驅動服務升級**：於2025年6月，我們成功為一家專業從事半導體研發、生產及銷售的領先客戶提供首個AI驅動的良率管理系統。我們的解決方案將缺陷圖像分析與人工智能相結合，可實現跟蹤良率因素，並提供實時警報，充分體現了我們在提供AI驅動的智能制造軟件解決方案方面的優勢。
- **海外業務擴展**：於2025年8月，我們在東南亞簽訂了首個大型海外工程，合約總金額約6.7百萬美元，涵蓋跨平台系統模塊及與我們生態系統業務合作夥伴的協作。該項目不僅彰顯了我們承接複雜跨境項目的能力，也為我們拓展全球業務奠定了堅實的基礎。

無重大不利變動

董事確認，直至本文件日期，自2025年4月30日（即本文件附錄一會計師報告呈報期間的截止日期）以來，我們的財務、交易狀況或前景並無重大不利變動，且自2025年4月30日以來並無會對本文件附錄一會計師報告所載資料產生重大影響的事件。